

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第3部門第3区分

【発行日】平成21年4月9日(2009.4.9)

【公開番号】特開2007-246561(P2007-246561A)

【公開日】平成19年9月27日(2007.9.27)

【年通号数】公開・登録公報2007-037

【出願番号】特願2006-68153(P2006-68153)

【国際特許分類】

C 08 J 7/00 (2006.01)

C 08 K 3/34 (2006.01)

C 08 K 3/38 (2006.01)

C 08 L 77/00 (2006.01)

B 29 C 45/00 (2006.01)

B 29 C 71/02 (2006.01)

B 29 K 77/00 (2006.01)

【F I】

C 08 J 7/00 302

C 08 K 3/34

C 08 K 3/38

C 08 L 77/00

B 29 C 45/00

B 29 C 71/02

B 29 K 77/00

【手続補正書】

【提出日】平成21年2月19日(2009.2.19)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

J I S K 6920-2に従って、98%硫酸にて測定した相対粘度が2.7以下の低分子量ポリアミド樹脂(A)100質量部に対して、少なくとも2個の重合性官能基を有する有機化合物(B)1~10質量部、粒子径が0.1~20μmのタルク、窒化ホウ素から選ばれる少なくとも1種類以上の充填材(C)100~5000ppm、リン系熱安定剤(D)0.01~10質量部からなる樹脂組成物を、所望の形状に射出成形した後、照射架橋して得られる23%、98%硫酸に実質的に不溶解である厚み10mm以下のポリアミド樹脂成形品。

【請求項2】

所望の形状に射出成形した後、アニール処理(窒素雰囲気下180℃で4時間)後、照射架橋して得られる請求項1に記載のポリアミド樹脂成形品。

【請求項3】

(C)タルク、窒化ホウ素から選ばれる少なくとも1種以上の充填材(C)の粒子径が2~8μmであることを特徴とする請求項1または2に記載のポリアミド樹脂成形品。

【手続補正2】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0010

【補正方法】変更

【補正の内容】

【0010】

すなわち、本発明は以下の通りである。

[1] J I S K 6 9 2 0 - 2 に従って、98%硫酸にて測定した相対粘度が2.7以下の低分子量ポリアミド樹脂(A)100質量部に対して、少なくとも2個の重合性官能基を有する有機化合物(B)1~10質量部、粒子径が0.1~20μmのタルク、窒化ホウ素から選ばれる少なくとも1種類以上の充填材(C)100~5000ppm、リン系熱安定剤(D)0.01~10質量部からなる樹脂組成物を、所望の形状に射出成形した後、照射架橋して得られる23、98%硫酸に実質的に不溶解である厚み10mm以下のポリアミド樹脂成形品、

[2] 所望の形状に射出成形した後、アニール処理(窒素雰囲気下180で4時間)後、照射架橋して得られるポリアミド樹脂成形品、

[3] (C)タルク、窒化ホウ素から選ばれる少なくとも1種以上の充填材(C)の粒子径が2~8μmであることを特徴とする請求項1または2に記載のポリアミド樹脂成形品。